

「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業／先端半導体製造技術の開発（助成）」

実施予定先一覧

No.	開発テーマ	実施予定先
1	(b) 先端半導体の後工程技術（More than Moore技術）の開発 (b1) 高性能コンピューティング向け実装技術	日本サムスン株式会社

以上